

热电分离铝基板 铝基覆铜板

产品名称	热电分离铝基板 铝基覆铜板
公司名称	深圳市金鼎利电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:铝基覆铜板 绝缘材料:玻璃布基板
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山万安路80号C1栋D1栋 (C1栋一楼西北面)
联系电话	13798257117 13048860983

产品详情

深圳市金鼎利电子有限公司成立于2003年，是一家专门从事高导热金属基绝缘电子材料研发、生产及其二次产品开发、生产加工的技术型民营企业。所采用的原材料通过长城认证，产品广泛应用于通信、电力、电子、医疗设备、机械设备、照明等领域。铝基印制电路板(铝基pcb/铝基板)具有良好的散热特性。采用铝基板工艺较采用环氧板工艺，可大幅提高各种大功率电路及模块的电流密度、工作可靠性和使用寿命。铝基印制电路板(铝基pcb/铝基板)还具有电磁屏蔽性，可防止电子元件遭受电磁波的辐射、干扰。线路制作工艺符合国家标准及ipc标准。

本产品的加工定制是是，种类是铝基覆铜板，绝缘材料是玻璃布基板，表面工艺是钻杯，表面油墨是白色，最小线宽间距是0.1，最小孔径是0.8，加工层数是单，板厚度是1.6 (mm)，粘结剂树脂是环氧，特性是通用型